

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系 活动类别	●特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 □其他
时间	2025 年 11 月 20 日 13:30-15:00 东吴证券、宝盈基金； 2025 年 11 月 27 日 13:30-15:30 国泰海通证券、国寿财险、国寿资产。
上市公司接 待人员姓名	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系 活动记录	董事会秘书吴能云就公司的发展历程、主营业务、竞争优势、产业应用、未来发展规划等向与会投资者做了详细的介绍。 公司投资者交流的问题回复内容如下： 1.请介绍一下公司的硅片发展方向？ 答：公司半导体硅片产品中既有轻掺硅片又有重掺硅片，轻掺硅片主要应用于存储、逻辑芯片等领域，重掺硅片主要应用于功率、模拟芯片等领域。公司硅片产品的优势在于重掺硅片的技术，目前公司的重掺硅片占国内市场份额超过 30%，低电阻率重掺系列产品工艺等技术可保持全球同步领先，可参与全球竞争。公司硅片的发展将聚焦于发挥重掺技术优势，大力发展重掺系列硅片产品，继续保持和提升市场份额。同时做强做大轻掺抛光片产品，在现有产能快速爬坡的基础上，发挥 BCD 硅片的技术强项，加快嘉兴金瑞泓的 12 英寸轻掺硅片的产能建设。 2.公司重掺硅片是否有涨价？ 答：目前公司重掺硅片因订单充足，出货量同比、环比均有大幅增长。在此情况下，公司优先选择高价值量产品订单，公司因出货结构的变化，自第一季度以来硅片平均出货价格环比逐季提升。